附件1

2023中国（深圳）集成电路峰会

参会回执表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | |  | | | |
| 电话 | |  | 地址 |  | |
| 联系人 | |  | 手机 |  | |
| 参会人员信息 | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 邮箱 | 住宿需求 |
| 1 |  |  |  |  | 有无 |
| 2 |  |  |  |  | 有无 |
| 3 |  |  |  |  | 有无 |
| 4 |  |  |  |  | 有无 |
| 合作意向：参展 演讲  其它，请注明：  备注：住宿可通过会务组统一预定协议酒店，需自费到店付。 | | | | | |

请各有关单位于2023年9月15日前填写《参会回执表》并邮件发送至会务组报名参会。联系人：寿女士：[0755-86169109，shouah@szsia.com](mailto:0755-86169109，shouah@szsia.com)；邹女士：0755-86156105，zoudy@szsia.com。